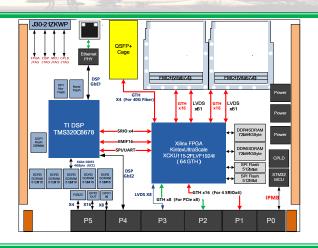


♣ 基于 KU115 FPGA+C6678 DSP 的 6U VPX 双 FMC 接口通用信号处理平台

Product ID: VPX638





技术指标

- 标准 6U VPX 规格,符合 VITA46 规范;
- 板载高性能 FPGA 处理器: XCKU115-2FFVF1924I
 - ▶ 外挂 2 组 72 位 DDR4 SDRAM, 每组 4GByte 容量;
 - ▶ 外挂 2 片 QSPI Flash, 总共 1Gbit 容量, 用于 FPGA 的加载;
 - ▶ 外挂 2 个 FMC+ HPC 接口;
- 板载 1 片高性能 DSP 处理器: TMS320C6678
 - ▶ 外挂 1 组 64 位 DDR3 SDRAM, 总容量 4GByte;
 - ▶ 外挂 1 片 Nor Flash,容量 512Mbit,用于 DSP 的加载;
 - ▶ 外挂 1 片 4Gbit Nand Flash 用于少量参数数据的存储;
 - ▶ 前面板支持1个 RJ45 干兆以太网接口,后出线1路 GbE;
 - ▶ FPGA 与 DSP 互联: 1路 SRIO x4@5Gbps/lane;
- VPX 背板互联
 - ▶ VPX P1: 支持 4 路 x4 SRIO 连接至 KU115 FPGA;
 - ➤ VPX P2: 支持 PCIE X8 连接至 KU115 FPGA;
 - ▶ VPX P3: 支持 LVDS X8 连接至 KU115 FPGA;
 - ▶ VPX P4: 支持 1 路 GBE, 连接至 DSP;
 - VPX P5: 支持 4 路 RS422 接口,支持 16 路 GPIO 输出,支持 8 路 GPIO 输入;
- 前面板 J30 接口
 - ▶ 支持1个FPGA下载、1个MCU下载、1个CPLD下载接口;
 - ▶ 支持 1 个 DSP 的下载接口;
- 物理与电气特征
 - ▶ 板卡尺寸: 160 x 233mm
 - ➤ 板卡供电: 6A max@+12V (±5%)
 - ▶ 散热方式: 风冷+导冷散热
- 环境特征
 - ▶ 工作温度: -40°~ + 85°C, 存储温度: -55°~ + 125°C;
 - ▶工作湿度: 5%~95%, 非凝结

板卡概述

VPX638 是一款基于 KU115 FPGA + C6678 DSP的 6U VPX 双 FMC 接口通用信号处理平台,该平台采用一片 Xilinx 的 Kintex UltraScale 系列 FPGA (XCKU115) 作为主处理器,完成复杂的数据采集、回放以及数据预处理。采用 1 片 TI 的多核浮点运算 DSP TMS320C6678 来完成信号处理算法。

该平台的主处理器 XCKU115 外挂两组 72 位 DDR4 SDRAM,来实现超大容量数据缓存,数据缓存带宽可以达到 2400MHz。KU115 FPGA 可以通过背板与其他板卡进行数据交互。KU115 FPGA 外挂 2个 FMC+ HPC 接口,支持 2个 FMC 子卡的扩展。该平台的 1 片 TI的 Keystone 系列多核浮点运算 DSP 处理器 TMS320C6678,支持2GByte的 DDR3 数据缓存,支持1路干兆以太网接口。与主 FPGA之间通过 SRIO 或者 EMIF来进行数据交互。

该板卡还支持 1 片单片机进行健康管理,并将状态信息通过 IPMB 总线上报,板卡支持 1 片 CPLD 芯片进行上电时序的控制。

该板卡为 VPX 风冷兼容导冷架构,具有优良的抗振动设计、散 热性能和独特的环境防护设计,适合于航空、航天、船舶等应用场景。

软件支持

● 提供底层接口驱动程序;

应用范围

● 软件无线电; 雷达与基带信号处理;

订购信息

产品型号	产品描述
VPX638	基于 KU115 FPGA+ C6678 DSP 的 6U VPX 双 FMC 接口
	通用信号处理平台